

Infrastructure à disposition de TAIPRO Engineering

<p>MAT : Machine semi automatique de Flip Chip ultrason et de pick and Place</p>		<p>PICK AND PLACE : Machine de pick and place</p>	
<p>WIRE BONDER : Soudure filaire par ultrason : Wedge , ball and bump bonding en Alu et en Or</p>		<p>MACHINE D'USINAGE : pour le gravage de PCB Machine hors SB</p>	
<p>PLASMA : traitement et activation de surface par ionisation de gaz</p>		<p>LEAK DETECTOR : Détection de fuite d'He pour les boîtiers hermétiques</p>	
<p>PULL AND SHEAR : Tests en traction et en cisaillement de soudure filaire et de colle ou brasure jusqu'à 5 kg</p>		<p>STATION DE VISUALISATION : Inspection visuelle de microsystemes</p>	
<p>SEAM SEALER : Fermeture hermétique de boîtier électronique</p>		<p>METALLISEUR : Dépôt Or sur PCB (équipement hors SB)</p>	
<p>SCRIBER : Découpe de gaufrettes en silicium</p>		<p>DECAPSULATION : Enlèvement d'encapsulant par attaque acide</p>	
<p>Salle Blanche et mobilier : Environnement propre maîtrisé et contrôlé, matériel tout à fait spécifique ESD et compatible Salle Blanche dans le respect des normes en vigueur.</p>			